公司代码:688630　　公司简称:芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配方案拟定如下:本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本报告披露日,公司总股本 131,740,716 股,以此计算合计派发现金红利 92,218,501.20 元(含税),占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.81%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司 2025 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯碁微装	688630	

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

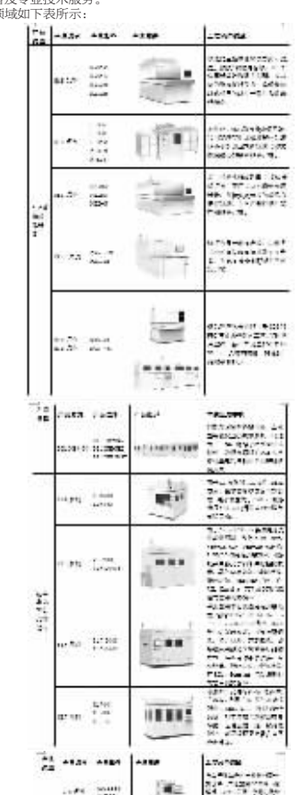
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏永珍	高露西
联系地址	合肥市高新区长宁大道 769 号	合肥市高新区长宁大道 769 号
电话	0551-63826207	0551-63826207
传真	0551-63822005	0551-63822005
电子信箱	yzwei@cfmee.cn	lxyuan@cfmee.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司以微纳直写光刻为核心技术,专注于高端直接成像设备与直写光刻设备的研发、制造、销售及维保服务。公司产品体系涵盖 PCB 直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备,技术能力覆盖微米至纳米级多领域光刻工艺环节,为印制电路板与泛半导体产业提供高性能光刻装备及专业技术服务。

主要产品及应用领域如下表所示:



2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司作为聚焦 PCB 及泛半导体领域的高端装备解决方案提供商,以高端专用设备销售为核心营收与利润支柱,面向下游行业客户提供贴合先进制造工艺需求的专业化设备产品,并配套提供全生命周期的周期性设备维保、技术支持等增值服务,构建核心产品销售 + 持续性技术服务深度协同的核心盈利体系。同时,公司立足客户多元化、场景化的业务需求,辅以少量设备租赁业务,通过灵活的服务模式收取相应租赁费用,作为盈利结构的有益补充,进一步拓宽收入来源、优化盈利质量,保障公司经营业绩实现持续、稳健、高质量发展。

2、研发模式

公司不断完善 IPD 研发管理体系,研发模式以自主研发为主,技术开发管理部 IPD 项目组是研发项目的归口管理部门,负责组织项目立项、评审和验收等管理工作。报告期内,公司加速 IPD 项目执行,推动全流程标准化落地,优化了技术开发、产品开发的方法、流程及制度,持续推进产品平台建设和矩阵式管理,保证新产品开发成功率,构筑技术、产品和解决方案的竞争力,确保公司有效增长。

公司按照集成产品开发 IPD 模式进行产品开发,主要研发流程包括:(1)根据市场、客户需求及技术发展趋势,市场部门与产品线配合进行充分市场调研后发起项目立项并制定初步产品开发计划;(2)立项通过后,进行系统架构和核心技术可行性的分析验证,并确认产品开发计划;(3)系统详细设计,包括系统子模块设计(光学模块、机械模块、电子模块、数据处理、电子及软件)和多种可能性设计(可测试性、可维护性、可靠性等)(4)详细设计通过审核后,进入研发样机制造与测试验证;(5)研发样机验证通过后,安排小批量进行可生产性验证,并安排客户端验证通过后,移交产品制造中心进行量产,转入产品生命周期维护阶段。在整个研发过程阶段节点,会分别从技术和商业成功两条主线安排评审,确保产品开发结果符合预期。

3、采购模式

在产品制造过程中,所需的主要材料包括核心组件和零部件。针对运动平台及组件、图形生成模块、光路组件、曝光光源、自动控制组件等核心组件及非标准零部件,公司通过提供设计方案、图纸和参数委托选定的优质供应商定制生产;或因功能模块的特殊需求以及出于成本控制和供应链安全的考虑,公司在评估模块自设计和集成能力的前提下,通过购买标准核心组件后再进行二次开发。针对常规标准零部件,公司面向市场进行独立采购。

为保证核心组件、零部件的品质,公司制定了严格、科学的采购制度,从供应商选择、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程,均实行有效的内控管理。具体采购方式有以下三种:(1)谈判式采购:对于核心组件和非标准零部件,为了确保产品的质量可靠,只备选国内外几家知名的供应商,建立稳定的合作关系,定期谈判以最优供货条件确定最终的供货方;(2)竞争性采购:对于常规标准零部件采取竞争性采购,遵选的条件包括质量、价格、付款条件、交期、服务等;(3)零星采购:对于价值低且需求量大的零部件,采用网上询价的方式。

对于部分交货期较长的进口核心组件,为缩短公司产品交货期,公司根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。为保证核心组件和零部件的供货质量,公司建立了供应商考核评价体系,根据质量、价格、交期等考核指标对供应商进行综合评分,优胜劣汰。

4、生产模式

按照产品特点及市场销售规律,公司采用“标准化生产 + 定制化生产”安排生产计划,主要采用自主生产模式,部分电路板焊接等非核心工序委托外协厂商生产。

A:标准化生产 + 定制化生产

标准化生产模式主要是针对 PCB 直接成像设备的生产。PCB 直接成像设备主要用于 PCB 规模化量产,一般情况下客户的定制化需求较少,客户需求标准相对统一,该设备主要采用标准化的生产模式。该模式下,公司根据客户下达的订单情况和对市场的需求预测来制定生产计划。对于市场需求稳定、销量高的设备,公司会维持一定数量的产品库存,以保证较短的交货周期。

定制化模式主要针对高端战略客户进行产品开发。此类产品需要根据客户的定制需求进行研发、生产,故主要采用定制化生产模式,实行以销定产。

B:自主生产 + 外协生产

生产过程中的零部件和模块组装、物理光学调试等核心工序由公司自主独立完成,公司从合作供应商处采购电子元器件、PCB 等原材料,然后将电路板焊接等非核心工序委托外协厂商完成。外协生产模式下,公司向外协厂商提供电子元器件、PCB 等原材料,外协厂商按照公司的产品规格、图纸、质量标准和工艺流程文件进行生产。市场上可供选择的同类型外协厂商较多,公司不存在依赖单一外协厂商的情形。

5、销售模式

公司采用直销为主,经销为辅的销售模式。

首先,公司获取客户资源的方式分为五种情况:一是公司随着产品性能及服务口碑的提升,建立了很好的品牌知名度,客户主动获取公司信息,与公司进行商洽;二是公司根据业务规划,主动与相关领域内的客户取得联系;三是已有的存量客户有新需求后,与公司进一步合作;四是公司通过展会、专业协会、技术交流会等相关活动获取客户信息;五是公司通过经销商、代理商获取客户信息。

其次,在销售与服务机构的设置方面,公司设有深圳分公司、苏州子公司、台湾办事处、江西办事处等,能够覆盖华南、华东、华中以及台湾地区的市场销售及售后服务。同时,公司通过经销代理商模式拓展海外市场,加大东南亚产业布局,同步辐射日韩等市场。通过多年的市场积累,公司的成功销售案例在下游客户市场中建立了良好的口碑,为公司开拓新客户提供了良好的市场基础。

第三,在销售服务的内部部门协同方面,公司的市场部、研发部门与客户有着良性且深入的沟通,切实解决客户的痛点问题,维持和不断强化与客户之间良好的供销关系。

第四,公司设备销售主要有三种形式:(1)直接与客户签订销售合同;(2)与客户先签订试用合同,试用期满后确认合格后再进一步签署销售合同。随着公司品牌及影响力提升,与客户签订试用合同的销售模式占比很小。(3)与经销代理商签署合同,由其负责相关区域产品推广及销售。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

作为国内领先的直写光刻设备厂商,公司专注服务于电子信息产业中 PCB 领域及泛半导体领域的客户,通过优质的产品帮助客户在提升产品品质和降低生产成本的同时实现数字化、无人化、智能化发展。

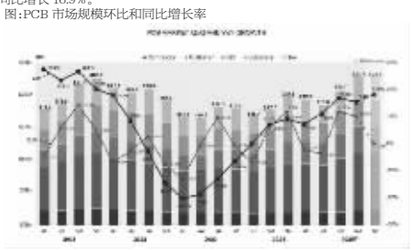
在 PCB 领域,公司设备主要应用于 PCB 制程中的线路层及阻焊层曝光环节,2024 年公司超越日资产商,成为全球最大的 PCB 直接成像设备制造商,全球市占率达 15%;此外,公司在 PCB 领域了还布局有激光钻孔设备,利用与 LDI 的算法互通性,实现高精度生产需求,有效帮助客户提升良率。在泛半导体领域,应用场景涵盖先进封装、IC 载板、FPD 面板显示、掩模版制版、新型显示等领域,产品布局丰富。

(1)PCB 行业

● 人工智能热潮推动 PCB 行业持续高增,中国和亚太市场增速领先

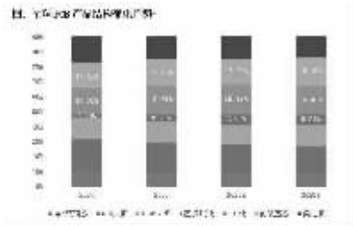
在 AI 产业的推动下,2025 年全球 PCB 市场规模达到 849 亿美元,同比增长 15.4%,增速较 2024 年进一步提升,其中第四季度市场规模达到 228 亿美元,同比增长 18%。结构上看,HDI 板和高多层板成为这一轮增长的主力军,其中 HDI 板市场规模为 157 亿美元,同比增加 25.6%;高多层板(18 层以上)市场规模 45 亿美元,同比增加 85.5%。此外,封装基板市场亦有较高增长,市场规模达到 147 亿美元,同比增长 16.9%。

图:PCB 市场规模环比和同比增长率



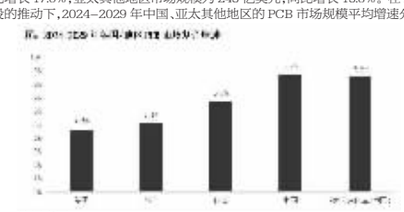
数据来源:Prismark

AI 服务器和数据中心建设或将成为 PCB 下游第一大应用。AI 基础设施建设极大提升了对 HDI 板、高多层板以及封装基板的需求,从 HDI 板市场来看,2025 年 HDI 板占整个 PCB 市场规模的 18.51%,2029 年这一比例将提升至 19.49%,成为 PCB 下游的第一大应用领域。HDI 市场增长源自 AI 服务器和数据中心的需求,2025 年 AI 服务器和数据中心对 HDI 板的需求同比翻倍,且预计保持高增长趋势,Prismark 预计 2029 年 AI 服务器和数据中心对 HDI 板的需求将达到 46.97 亿美元,2024-2029 年复合增长率达到 29.6%。总体来看,2029 年 AI 服务器、数据中心对 PCB 的需求预计将达到 257 亿美元,占 PCB 整体市场的 22%。



数据来源:Prismark

分区域来看,中国和亚太其他地区增速领跑全球。2025 年中国 PCB 市场规模达到 485 亿美元,同比增长 17.6%;亚太其他地区市场规模为 243 亿美元,同比增长 13.8%。在 AI 服务器等 AI 基础设置建设的推动下,2024-2029 年中国、亚太其他地区的 PCB 市场规模平均增速分别为 8.7%、8.6%。



数据来源:Prismark

● AI 需求推动 PCB 技术路径变革与上游设备能力迭代升级

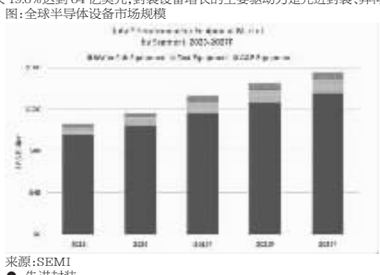
随着 AI 服务器与高性能数据中心对算力密度的极致追求,PCB 产品正加速向超高层数(20 层以上)、极高密度互连(HDI Any-layer)及类载板(SLP)形态演进。相较于消费电子等其他应用领域的 LDI 设备,AI 算力场景的 LDI 设备存在显著的技术代差与准入门槛,如 AI 服务器主板因层数多、材料复杂,在多次压合工艺中会产生剧烈的非线性涨缩与翘曲,需要设备有极高精度的层间对位能力。普通设备仅能进行简单的线性补偿,公司的高端 LDI 设备搭载了专有的高阶非线性形变校正算法与分区动态配准技术,能够实时补偿基板的复杂形变,确保在数十层堆叠中实现微米级(±5μm 以内)的层间对位精度,这是保障 AI 芯片电气互连可靠性的核心指标;此外,在极限解析度与细线路良率上,针对 AI 芯片载板级封装需求(线宽 / 线距(10/10μm),高端设备采用了多波长耦合光源与大景深光学系统,有效克服了高多层板表面的高低起伏,确保了在更精细线宽下的侧壁陡直度与线宽一致性,突破了普通设备的光学衍射极限;最后,AI 场景的 LDI 设备需要在完成大数据量吞吐的同时保证产能效率,AI 高多层板的数据量呈指数级增长,单板数据量可达数百 GB。需要设备配备高性能处理引擎,在处理海量数据的同时保持高速扫描曝光,兼顾精度和效率。

公司是国内极少数能满足 AI 服务器及数据中心严苛标准的高端 LDI 设备供应商,具备量产供货能力并进入行业头部客户供应链,已成功实现了对该类设备的国产化替代,确立了在高性能计算基础设施制造环节的领先优势与独占地位。

(2)泛半导体行业

根据国际半导体产业协会 SEMI 的数据,2025 年全球半导体制造设备销售总额预计达到 1,330 亿美元,同比增长 13.7%,创历史新高;且 2026 年和 2027 年有望继续攀升至 1,450 亿美元和 1,560 亿美元;半导体设备市场的强劲增长主要由人工智能相关投资拉动。分产品看,晶圆厂设备(含晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜 / 掩膜版设备)2025 年市场规模达到 1,157 亿美元;而测试设备和封装设备销售额增长则更为强劲,2025 年测试设备市场规模同比增长 48.1% 达到 112 亿美元,封装设备市场规模同比增长 19.6% 达到 64 亿美元,封装设备增长的主要驱动力是先进封装、异构封装的加速渗透。

图:全球半导体设备市场规模



来源:SEMI

● 先进封装

摩尔定律的延伸受到物理极限,先进封装可以相对轻松地实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。先进封装在提高芯片集成度、缩短芯片距离、加快芯片间电气连接速度以及性能优化的过程中扮演了更重要角色。正成为助力系统性能持续提升的重要保障,并满足“轻、薄、短、小”和系统集成化的需求。在人工智能、高性能计算、5G 和自动驾驶的推动下,先进封装市场规模保持较快增速,YOLE 预计 2030 年先进封装市场规模将超过 800 亿美元,2024-2030 年平均增长率达 10.7%。其中 2.5D/3D 技术正成为 AI 相关需求的首选解决方案,随着 2.5D/3D 集成技术不断成熟,硅中介层面积显著扩大,重布线(RDL)线距微缩至 5μm,封装性能与可靠性进一步提升,YOLE 预计 2029 年 2.5D/3D 封装市场规模将达到 280 亿美元,平均增速高达 37%。

直写光刻技术凭借无掩模、高分辨率及工艺灵活性优势,在先进封装制造中地位日益重要。其广泛应用于高密度互连、晶圆级封装(WLP)以及复杂封装结构的微细图形加工,助力实现高精度微纳加工需求。公司自主研发的晶圆级光刻设备 WLP2000,最小解析半径为 2μm,目前已成功导入多家先进封装厂商生产线,完成多项工艺验证,逐步实现规模化量产,推动产业技术升级和良率提升。未来先进封装与直写光刻技术的深度融合将持续驱动半导体封装工艺升级,满足人工智能、高频通信、新能源汽车等新兴应用对高性能封装的多样化需求。

● IC 载板

在 AI 基础设施建设推动 IC 载板的尺寸增大,布线密度、信号完整性等要求不断提升,推动 IC 载板市场规模持续增长;Prismark 数据显示 2025 年 IC 载板市场规模 147.27 亿美元,同比增长 16.9%。展望未来,在 AI 服务器和数据中心的推动下,2029 年 IC 载板市场规模有望达到 200.87 亿美元,2024-2029 年复合增长率达到 9.8%。

追求更精细的线宽及分辨率成为大厂的主要发展方向,直接成像技术取代传统曝光技术成为主流技术。公司针对 IC 封装载板现已开发出 MAS4、MAS6、MAS8 系列产品,MAS4 已经实现了 4μm 线宽,达到海外一流竞品水平,设备在客户端验证顺利。公司产品凭借良好的技术、本地化服务优势取得了各大客户的认可,拓展了深南电路、鹏鼎控股、兴森科技、浩远电子、明阳电路、柏承微电子、英创力等优质客户。

● 掩膜版制版

根据灼识咨询数据,全球掩膜版市场规模预计将从 2024 年的 515 亿元增长至 2030 年的约 710 亿元,复合年增长率为 5.5%。厂商格局看,Photronics、Toppan(凸版印刷)与大日本印刷(DNP)三大国际企业仍主导全球市场,近年来中国大陆本土厂商如冠石科技、清溢光电、龙图光罩等不断推进国产化替代。此外,政策支持、资本投入、设备技术进步等多重因素共同作用,加速了掩模版产业的本地化发展。受益于先进制程升级、新兴终端应用增长(如 AI、汽车电子、5G)及区域供应链调整,全球掩模版市场正朝向高技术、高门槛、高集中度与多极化并存的格局演化,未来竞争将更加聚焦于高端产品能力与区域产能布局的协同发展。

在掩膜版制造过程中,直写光刻技术凭借其数字图案调整及智能动态校正的优势,已成为理想的微纳米光刻解决方案。全球掩膜版制造领域直写光刻设备的市场规模预计将从 2024 年的约 41 亿元增长至 2030 年的约 44 亿元,复合年增长率为 1.3%。

● 功率器件

2025 年功率器件市场持续稳健发展,尤其在新能源汽车、工业控制、可再生能源和数据中心等终端应用需求强劲的带动下,SiC(碳化硅)和 GaN(氮化镓)等第三代半导体器件快速渗透,成为推动产业增长的核心动力。QY Research 预计未来全球功率器件市场规模将保持稳定增长,2025-2031 年平均增长率为 4.3%。

在这一背景下,功率器件对封装尺寸、导电效率、热管理能力和制造精度提出更高要求,进而推动光刻工艺向高解析度、小线宽方向演进。传统掩模光刻在非标准化、低批量、高精度需求下面临灵活性不足问题,直写光刻技术因具备无掩模、高分辨率、高精度以及工艺灵活性等优势,越来越多地被用于功率器件制造中的关键工序,如栅极图形、电极对准、隔离沟槽刻蚀等环节。公司推出的高精度直写设备 MLF 已进入多家功率半导体产线验证或导入阶段。在功率器件需求增长与制造复杂度提升相互的作用下,直写光刻在这一细分市场的渗透率上升,正逐步从研发辅助工具向量产关键设备角色转变。

● 新型显示

2025 年新型显示产业持续扩张,Micro-LED、OLED 和 Mini-LED 等先进显示技术加快商业化进程,驱动上游制造工艺不断升级。在显示像素精度、器件微缩化和高 PPI(像素密度)需求日益提升的背景下,传统掩模制程在面临多种面板尺寸、定制化设计和超微结构精度要求时逐渐暴露出灵活性不足、掩模成本高昂、迭代周期长等问题。直写光刻技术凭借其无掩模、高解析度、设计灵活、快速打样等优势,正日益成为新型显示制造,尤其是在 Micro-LED 芯片图案化、TFT 基板驱动电极设计、彩色滤光片图案、光波导耦合结构等环节的关键工艺选择之一。

2025 年初,国内外多家厂商加速布局相关技术,部分头部显示厂已将直写设备用于 Micro-LED 巨量转移前的图案修复与微结构加工,提高良率和设计自由度,适配 OLED 和 Mini-LED 柔性背板工艺流程。同时,AR/VR 用超高精密微显示芯片的发展也为直写光刻带来新的增长点,尤其在波导器件图形加工和纳米级结构制造方面具备较强替代潜力。在政策支持和下游多样化显示应用驱动下,直写光刻在新型显示领域的技术渗透率持续上升,正在从样品开发、低量定制迈向中规模量产阶段,成为实现显示微结构创新和提升制造柔性的支撑力量。灼识咨询数据显示,2030 年全球平板显示器面板制造领域直写光刻设备的市场规模将达到 7 亿元,2024-2030 年复合年增长率为 18%。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是光刻技术领域里拥有关键核心技术的 PCB 直接成像设备及泛半导体直写光刻设备的国产供应商之一,是国内最早从事直写光刻设备开发的企业之一,是国内首家光刻设备上市公司。核心技术团队成员具备三十多年的高端装备开发经验,深耕行业多年。在 PCB 领域,公司 2024 年在全球 PCB 直接成像设备供应商中排名第一,市占率达到 15%,公司高端线路设备主要指标处于国际一流梯队,且部分指标已实现对海外品牌的赶超。在泛半导体领域,公司全面布局,IC 载板产品性能已比肩国际厂商,6 微米量产设备已在头部客户处批量完成验收。先进封装领域,公司扇出级和板级直写光刻设备取得重大市场突破,客户覆盖国内多家头部封装厂商。同时不断推出用于 IC 掩模版制版、功率器件、MEMS 芯片、陶瓷封装、新型显示等细分领域的泛半导体直写光刻设备,在半导体设备领域技术储备充足。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着 AI 的加速发展,行业头部公司不断推出新的技术路线,如在 AI 芯片的封装领域,技术路径由当前的 CoWoS 向 CoPoS 和 CoWoP 演变,下游 PCB 制造商和设备公司需要不断迭代目身工艺及产品以满足头部客户的需求。以 CoWoP 封装技术为例,其不再需要 ABF 载板,直接将芯片通过中介层键合到类载板(SLP)上,从而缩短电路路径、优化供电效率、提升散热性能和信号完整性,此外还能省去基板成本。相较于 HDI 板,SLP 对设备解析能力、对位精度及线宽一致性提出了更高的要求;针对未来的 CoWoP 技术,芯碁推出了 MAS 6P 线路系列和 NEX 30 阻焊系列,为头部客户的 CoWoP 产品量产做好充分的技术储备。

随着 AI 芯片尺寸变大,设计变复杂,传统的圆形晶圆面积利用率和封装效率逐渐受限,全球头部公司如台积电等开始考虑摒弃传统的圆形晶圆,将芯片在方形面板上进行封装,从而提升产出效益、降低生产成本,如台积电预计推出的 CoPoS 技术;在 CoPoS 技术中,中介层由圆变方,且因为芯片尺寸增大,需要内埋的硅桥数量亦会增加,因此会出现更多的偏移、翘曲问题,直写光刻技术由于无需物理掩模版,可以实现实时纠偏、再布线,在 CoPoS 技术中的优势更加突出。

图:AI 芯片封装技术路径

来源:Prismark

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,116,654,513.00	2,788,843,157.82	11.75	2,480,473,001.97
归属于上市公司股东的净资产	2,308,371,801.87	2,062,601,576.72	11.92	2,031,690,393.13
营业收入	1,408,121,260.32	953,942,796.24	47.61	828,855,419.07
利润总额	329,717,726.94	171,068,236.36	92.74	196,031,272.32
归属于上市公司股东的净利润	289,933,018.30	160,695,258.36	80.42	179,305,770.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,328,664.07	148,567,777.03	86.00	157,908,109.96
经营活动产生的现金流量净额	91,864,927.65	-71,549,480.73	228.39	-129,426,112.95
加权平均净资产收益率(%)	13.28	7.91	增加5.37个百分点	12.17
基本每股收益(元/股)	2.21	1.23	79.67	1.43
稀释每股收益(元/股)	2.21	1.23	79.67	1.43
研发投入占营业收入的比例(%)	9.32	10.24	减少0.92个百分点	11.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	242,243,064.27	412,090,272.58	279,171,179.69	474,616,763.78
归属于上市公司股东的净利润	51,866,624.57	90,166,334.69	56,779,189.44	91,120,669.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,587,326.98	84,354,363.64	56,759,466.46	83,627,517.99
经营活动产生的现金流量净额	-31,314,756.78	-73,934,466.10	69,530,215.89	127,583,934.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
程save	-940,000	35,847,490	27.21	0	无	0	境内自然人
宁波亚歌创业投资合伙企业(有限合伙)	-3,150,000	9,450,000	7.17	0	无	0	其他
宁波顶擎创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,248,236	3,458,690	2.63	0	无	0	其他
深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市引航国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-876,469	1,350,000	1.02	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,302,679	1,302,694	0.99	0	无	0	其他
方林	0	1,100,000	0.83	0	无	0	境外自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	1,100,000	1,100,000	0.83	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	175,714	837,080	0.64	0	无	0	其他
何少锋	-300,000	820,000	0.62	0	无	0	境内自然人
杨林	800,000	800,000	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			程卓为宁波亚歌创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波顶擎创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人杨雨庆为程卓姐姐之配偶。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

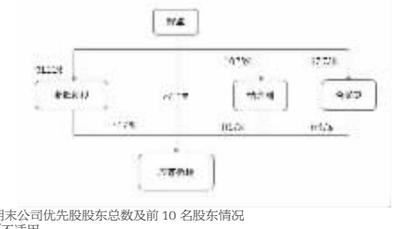
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 140,812.13 万元,同比增长 47.61%,归属于上市公司股东的净利润 28,993.30 万元,同比增长 80.42%,公司主要业务增长来自于核心业务板块 PCB 业务与泛半导体业务协同发力、多点突破,有效承接行业增量需求。经营活动产生的现金流量净额同比上升 228.39%,主要系销售回款增加所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688630　证券简称:芯碁微装　公告编号:2026-011

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第四会议,审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的公司章程的议案》。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

基于公司发行 H 股并上市需要,根据公司发行 H 股并上市进程以及香港中央结算有限公司(HKSCC)对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,对 H 股发行上市后适用的《公司章程》进行修订,具体修订内容如下(修订处加粗表示):

修订前	修订后
第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第六十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第一百二十五条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前(不包括会议召开当日)书面通知全体董事。	第一百二十五条 董事会每年至少召开4次会议,由董事长召集,于会议召开14日以前(不包括会议召开当日)书面通知全体董事。

除上述修订的条款外,H 股上市后适用的公司章程其他条款保持不变,修订后的《公司章程(H 股适用)》尚需提交公司股东会审议,并自公司发行的境外上市股份(H 股)于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。修订后的《公司章程(H 股适用)》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:688630　证券简称:芯碁微装　公告编号:2026-013

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥芯碁微电子装备股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 l(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

(二)项目成员信息

1.项目组人员信息

项目合伙人:王彩霞,2011 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过森泰股份(301429.SZ)、美邦股份(605033.SH)、芯碁微装(688630.SH)、井松智能(688251.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:姚娜,2020 年成为中国注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过安科生物(300009.SZ)、芯碁微装(688630.SH)2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人:陈芳,2009 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2021 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过杭齿前进(601177.SH)、巨化股份(600160.SH)、万通智控(300643.SZ)、福赛科技(301529.SZ)等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

签字